

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2025-033

上海艾为电子技术股份有限公司

截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A 股）41,800,000 股，发行价格为每股 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000.00 元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币 165,782,585.36 元后，实际募集资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第 4-00042 号的验资报告。

根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议，本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用（含税）合计人民币 150,058,795.06 元；本公司募集资金扣除承销保荐费用（含税）后的人民币 3,050,985,204.94 元已于 2021 年 8 月 10 日存入本公司在中国银行上海市吴中路支行的 439081861450 银行账户。

（二）前次募集资金的存放及管理情况

公司募集资金全部存放在募集专户内，截至 2025 年 06 月 30 日止，公司募集资金专户的存储具体情况如下：

开户机构	账号	初始存放金额 (元)	截止日 账户余额 (元)	备注
招商银行上海分行营业部	121939323310888	-	-	已销户

招商银行上海分行营业部	121928744310666	-	996,517.32	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013001344792	-	26,496,530.46	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013501352188	-	25,759,353.58	
中国银行上海市吴中路支行	439081861450	3,050,985,204.94	19,740,011.13	
上海银行闵行支行	03004644696	-	18,454,220.80	
上海银行闵行支行	03004644378	-	68,536.57	
中信银行上海分行营业部	8110201012101685873	-	41,192,847.71	
上海银行闵行支行	03005501767	-	1,240,401.48	
中国银行上海市吴中路支行	446885714103	-	29,103,439.46	
招商银行上海分行营业部	121939323310118	-	-	
上海银行闵行支行	03005824825	-	3.02	
上海银行闵行支行	03005824795	-	0.61	
上海银行闵行支行	03005824817	-	9.41	
上海银行莘庄支行	03005824787	-	-	
招商银行上海分行营业部	121941213410012	-	3.42	
招商银行上海分行营业部	121939330310013	-	15.85	
招商银行上海分行营业部	121944966010017	-	3.71	
招商银行上海分行营业部	121945865310018	-	2.70	
招商银行上海分行营业部	121953529210020	-	0.33	
招商银行上海分行营业部	411910565110021	-	1.44	
招商银行上海分行营业部	121980045910022	-	8.75	
合计		3,050,985,204.94	163,051,907.75	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司分别于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，同意将“研发中心建设项目”投资总额由 40,824.76 万元变更为 21,892.29 万元，使用募集资金拟投入金额由 40,824.76 万元变更为 21,892.29 万元，为进一步提高募集资金使用效率拟将“研发中心建设项目”调整后的剩余募集资金用于公司募

投资项目“电子工程测试中心建设项目”。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

鉴于募集资金投资项目“研发中心建设项目”公司已通过自有资金购置办公楼的方式完成了项目的研发和技术升级，并已达到预定的产品研发目标，公司将该项目结项。同时，由于“电子工程测试中心建设项目”的建设周期长、技术挑战多、开发复杂度高，需要配备大量高素质技术人员，同时建设测试生产线，提升公司芯片测试的产能，确保公司在未来半导体发展的局势中占据行业主导地位，公司将“研发中心建设项目结项后的剩余募集资金 20,205 万元用于“电子工程测试中心建设项目”。并将“电子工程测试中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 8 月延长至 2026 年 3 月。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司于 2021 年 10 月 29 日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为 271,352,274.98 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海艾为电子技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 4-10031 号）。公司已完成了预先投入募投项目资金全部置换，总额为 271,352,274.98 元。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 9 月 7 日，本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 78,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。2022 年 8 月

22 日，公司已将暂时补充流动资金 78,000 万元全部归还。

2022 年 8 月 23 日，本公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下，继续使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。2023 年 8 月 17 日，公司已将暂时补充流动资金 60,000 万元全部归还。

2023 年 8 月 18 日，本公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。2024 年 8 月 15 日，公司已将暂时补充流动资金 60,000 万元全部归还至募集资金专户。

2024 年 8 月 16 日，本公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。截至 2025 年 6 月 30 日止，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为 57,100 万元。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 9 月 7 日，本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币 26 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性

高、流动性好的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

2022 年 8 月 23 日，本公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，用于购买安全性高、流动性好的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

2023 年 8 月 18 日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

2024 年 8 月 16 日，本公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

截至 2025 年 06 月 30 日止,公司用于购买现金管理产品的期末余额为 25,000 万元,未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

存放机构	产品名称	金额(元)	购买日	到期日	公司主体
申万证券	龙鼎定制 1442 期	50,000,000.00	2024-9-3	2025-7-28	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	20,000,000.00	2025-3-25	2025-7-21	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	30,000,000.00	2025-4-29	2025-7-28	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	25,000,000.00	2025-5-27	2025-8-25	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	65,000,000.00	2025-4-3	2025-7-30	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	14,000,000.00	2025-4-29	2025-7-28	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	25,000,000.00	2025-4-24	2025-7-23	上海艾为微电子技术有限公司
上海银行	结构性存款	21,000,000.00	2025-5-15	2025-8-13	上海艾为微电子技术有限公司
合计		250,000,000.00			

3、前次募集资金节余及节余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金总额金额为 216,550.68 万元,占前次募集资金净额的比例为 71.34%;募集资金节余金额为 98,405.19 万元(包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额 11,464.36 万元,以及未到期结构性存款 20,000.00 万元、理财本金 5,000.00 万元),将继续用于募集资金投资项目。

(五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2023 年 4 月 13 日,本公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用剩余全部超募资金 47,220 万元及其衍生利息、现金管理收益用于投资建设新项目。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。2023 年 5 月 11 日,本公司召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》。

(六) 募集资金使用的其他情况

1、超募资金用于补充流动资金(已取消)

2021 年 9 月 7 日,本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第

五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 17,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.98%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。该议案已经 2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。2021 年 9 月 28 日，公司自募集资金专户中合计转出 17,000 万元的超募资金用于永久补充流动资金。

2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案》，同意公司取消此前使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户进行专户储存与三方监管。公司独立董事与保荐机构就此事项均无异议。该议案已经 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过。2021 年 11 月 15 日，公司已将上述 17,000 万元退回至募集资金专户。

2、超募资金用于回购公司股份

2022 年 8 月 23 日，本公司召开了第三届董事会十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以公司超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划，回购价格不超过 180 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。公司已完成回购股份，已使用超募资金人民币 100,044,003.51 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

3、募集资金使用过程中置换

2023 年 8 月 18 日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监

事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。本公司基于业务发展的实际情况，采用集中采购和支付的方式，即公司及子公司先以自有资金支付募投项目相关款项包括研发人员在募投项目的薪酬、材料、试制测试、光罩、研发相关零星支出等，当月编制置换申请单，按照公司《募集资金管理制度》规定逐级审批后，由募集资金专项账户等额置换划转至公司及子公司的自有资金账户。

4、其他募投项目调整

2023年8月18日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海艾为微电子有限公司作为募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”、“马达驱动芯片研发和产业化项目”及“高性能模拟芯片研发和产业化项目”的实施主体。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

2024年4月8日，本公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》，同意对“电子工程测试中心建设项目”将原计划达到预订可使用状态日期2024年8月延期至2026年3月。同意对“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”、“马达驱动芯片研发和产业化项目”的内部投资结构进行调整。同意增加全资子公司上海艾为微电子有限公司作为募投项目“发展与科技储备资金”的实施主体。同意增加全资子公司无锡艾为集成电路技术有限公司、苏州艾为集成电路技术有限公司和成都艾为微电子科技有限公司作为募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”、“马达驱动芯片研发和产业化项目”、“高性能模拟芯片研发和产业化项目”及“发展与科技储备资金”的实施主体。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

2025年1月16日，本公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资

子公司上海艾为集成电路技术有限公司、上海艾为半导体技术有限公司、深圳艾为集成电路技术有限公司、合肥艾为集成电路技术有限公司、哈尔滨艾为微电子技术有限公司、大连艾为微电子技术有限公司、北京艾为微电子技术有限公司作为募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G 射频器件研发和产业化项目”、“马达驱动芯片研发和产业化项目”、“高性能模拟芯片研发和产业化项目”及“发展与科技储备资金”的实施主体。保荐人就此事出具了明确的核查意见。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2025 年 6 月 30 日，研发中心建设项目、电子工程测试中心建设项目和发展与科技储备资金不能直接产生效益；智能音频芯片研发和产业化项目、5G 射频器件研发和产业化项目、马达驱动芯片研发和产业化项目和高性能模拟芯片研发和产业化项目尚在建设中，不单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告于 2025 年 7 月 27 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海艾为电子技术股份有限公司

2025年7月29日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			303,526.14			已累计使用募集资金总额：				216,550.68	
						各年度使用募集资金总额：				216,550.68	
变更用途的募集资金总额：			20,205.00			2021 年：		43,217.72			
变更用途的募集资金总额比例：6.66%						2022 年：		52,623.59			
						2023 年：		35,705.06			
						2024 年：		51,177.13			
						2025 年 1-6 月：		33,827.18			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	智能音频芯片研发和产业化项目	智能音频芯片研发和产业化项目	44,164.59	44,164.59	41,298.56	44,164.59	44,164.59	41,298.56	-2,866.03	2025 年 8 月	
2	5G 射频器件研发和产业化项目	5G 射频器件研发和产业化项目	21,177.05	21,177.05	15,623.49	21,177.05	21,177.05	15,623.49	-5,553.56	2025 年 8 月	
3	马达驱动芯片	马达驱动芯片	36,789.12	36,789.12	26,687.05	36,789.12	36,789.12	26,687.05	-10,102.07	2025 年 8 月	

	研发和产业化项目	研发和产业化项目								
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	40,824.76	20,619.76	21,892.29	40,824.76	20,619.76	21,892.29	1,272.53	2023 年 10 月
5	电子工程测试中心建设项目	电子工程测试中心建设项目	73,858.20	94,063.20	68,105.95	73,858.20	94,063.20	68,105.95	-25,957.25	2026 年 3 月
6	发展与科技储备资金	发展与科技储备资金	30,000.00	30,000.00	17,668.27	30,000.00	30,000.00	17,668.27	-12,331.73	2025 年 8 月
7	超募资金	超募资金	56,712.42	10,004.40	10,004.40	56,712.42	10,004.40	10,004.40		不适用
8	高性能模拟芯片研发和产业化项目	高性能模拟芯片研发和产业化项目		46,708.02	15,270.68		46,708.02	15,270.68	-31,437.34	2026 年 6 月
合计			303,526.14	303,526.14	216,550.68	303,526.14	303,526.14	216,550.68	-86,975.46	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年		
1	智能音频芯片研发和产业化项目	不适用	预计项目内部收益率为 25.21%（税后）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	5G 射频器件研发和产业化项目	不适用	预计项目内部收益率为 24.04%（税后）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	马达驱动芯片研发和产业化项目	不适用	预计项目内部收益率为 26.66%（税后）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研发中心建设项目	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	电子工程测试中心建设项目	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	发展与科技储备资金	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	超募资金	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	高性能模拟芯片研发和产业化项目	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用